



La gamme ICONNECT, issue de la Plateforme ICON, fait partie du programme LIT (Technologie d'identification du Label) qui a été développé par SMAG Graphique dans le but d'être le pionnier et le plus avancé des partenaires dans le monde de l'industrie des étiquettes intelligentes.

La ICONNECT est une plateforme multi-procédés conçue pour répondre aux marchés des donneurs d'ordres, mais aussi pour les imprimeurs d'étiquettes afin de leur offrir de nouvelles opportunités de marchés, en proposant des solutions pour la gestion des stocks en ligne, la traçabilité et l'identification des produits.

La ligne de façonnage RFID **ICONNECT•C** permet de :

- Insérer une puce RFID/NFC/puce anti-vol entre une étiquette adhésive et son support.
- Déposer une étiquette sur une autre étiquette pour la réalisation de coupons promotionnels ou pour un effet créatif.
- Déposer une étiquette de forme ou de matière différente à côté d'une autre étiquette (marché viticole).

Spécifications techniques

Laize minimum	40 mm
Laize maximum : Disponible en 3 modèles de Laize Existe Également en version MAX 350 mm	180 - 200 et 250 mm
Laize maximum de la puce et de l'étiquette insérées en fonction de la tête de pose choisie	160 mm ou 240 mm
Vitesse maximum (selon formats de la puce et de l'étiquette insérées) et de l'option de la tête de pose	80 m/min ou 150 m/min
Tolérance du repérage longitudinal de l'application de la puce	+/- 1 mm
Tolérance du repérage latéral de l'application de la puce	+/- 0,5 mm
Distance minimum entre deux poses (selon formats de la puce et de l'étiquette insérées)	Minimum 15 mm
Diam. maximum dérouleur	450 mm en Standard et 600 mm en Option
Diam. maximum enrouleur	450 mm
Diam. Maximum dérouleur tête de pose	400 mm
Diamètre standard des mandrins mais autres tailles disponibles	76 mm



iconnect•c

Solution de convertant pour les étiquettes intelligentes

Ligne de façonnage en ligne RFID

Base machine

- Débobineur avec mandrin pneumatique et frein à poudre.
- Guide bande à Ultrason.
- Section de délamination et re lamination.
- Photocellule pour la dépose en repérage avec possibilité de lire l'échenillage ou une marque imprimée sur le support (recto ou verso).
- Écran tactile HMI de commande des fonctions et paramètres de la machine.
- Rembobineur servo motorisé avec mandrin pneumatique.

Groupe de dépose

- Groupe de dépose à haute Vitesse et haute précision.
- Réglage de la position du groupe dans la laize machine.
- Second guide bande à ultrason.
- Synchronisation de la vitesse par codeur.
- Repérage de la dépose réglable par avance ou retard programmable.
- Groupe d'appel servo motorisé pour une dépose du tag en repérage avec l'étiquette.

Procédés disponibles supplémentaires de contrôle, Impression variable et façonnage

- Contrôle via caméra d'inspection 100% (EL ou BST) du positionnement dimensionnel de la puce déposée.
- Seconde section de pose.
- Impression de données variables pour la sérialisation ou pour le procédé d'encodage par lecture de code data matrix.
- Contrôle de la qualité de la puce RFID HF ou UHF avec gestion des données.
- Marquage des étiquettes contenant une puce RFID défectueuse.
- Destruction des puces défectueuses.
- Rembobineur supplémentaire avec passage de bande spécial pour puce à forte épaisseur.
- Groupe de refente à lames.
- Rembobineur à deux arbres ou touret semi-automatique.

